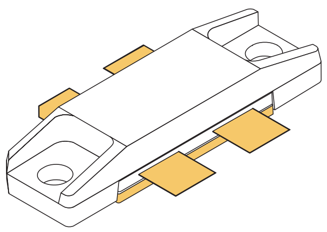
STAC2932B

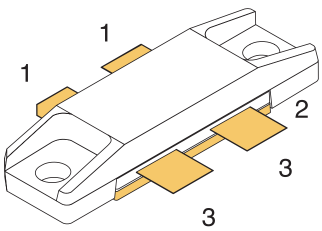
HF/VHF/UHF RF power N-channel MOSFETs

Datasheet - production data



STAC244B
Air cavity

Figure 1. Pin connection



1. Drain
2. Source (bottom side)
3. Gate

Features

- Gold metallization
- Excellent thermal stability
- Common source push-pull configuration
- P_{OUT} = 300 W min. with 20 dB gain @ 175 MHz
- In compliance with the 2002/95/EC European directive
- ST air cavity packaging technology - STAC™ package

Description

The STAC2932B is a gold metallized N-channel MOS field-effect RF power transistor, intended for use in 50 V DC large signal applications up to 250 MHz.

The STAC2932B benefits from the latest generation of efficient, patent-pending package technology, otherwise known as STAC™.

Table 1. Device summary

Order code	Marking	Base qty.	Package	Packaging
STAC2932BW	STAC2932(1)	20	STAC244B	Tray

1. For more details please refer to *Chapter 7: Marking, packing and shipping specifications*.

Contents

1 Electrical data

1.1 Maximum ratings

(T_{CASE} = 25 °C)

Table 2. Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_{(BR)DSS}$[(1)]	Drain source voltage	125	V
V_{DGR}	Drain-gate voltage (R_{GS} = 1 MΩ)	125	V
V_{GS}	Gate-source voltage	±20	V
I_D	Drain current	40	A
P_{DISS}	Power dissipation	625	W
T_J	Max. operating junction temperature	200	°C
T_{STG}	Storage temperature	-65 to +150	°C

1. T_J = 150 °C

1.2 Thermal data

Table 3. Thermal data

Symbol	Parameter	Value	Unit
R_{thJC}	Junction - case thermal resistance	0.28	°C/W

2 Electrical characteristics

T_{CASE} = +25 °C

2.1 Static

Table 4. Static (per side)

Symbol	Test conditions			Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{(BR)DSS}$	V_{GS} = 0 V	I_{DS} = 100 mA		125			V
I_{DSS}	V_{GS} = 0 V	V_{DS} = 50 V				50	µA
IGSS	V_{GS} = 20 V	V_{DS} = 0 V				250	nA
$V_{GS(Q)}$	V_{DS} = 10 V	I_D = 250 mA		1.5	2.5	4.0	V
$V_{DS(ON)}$	V_{GS} = 10 V	I_D = 10 A				3.0	V
G_{FS}	V_{DS} = 10 V	I_D = 5 A		5			S
C_{ISS}	V_{GS} = 0 V	V_{DS} = 50 V	f = 1 MHz		468		pF
C_{OSS}					206		pF
CRSS					16		pF

2.2 Dynamic

Table 5. Dynamic

Symbol	Test conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
P_{OUT}	V_{DD} = 50 V, I_{DQ} = 2 x 250 mA, P_{IN} = 4 W, f = 175 MHz	300	390		W
h_D	V_{DD} = 50 V, I_{DQ} = 2 x 250 mA, P_{IN} = 4 W, f = 175 MHz	55	68		%

3 Impedance

Figure 2. Current conventions

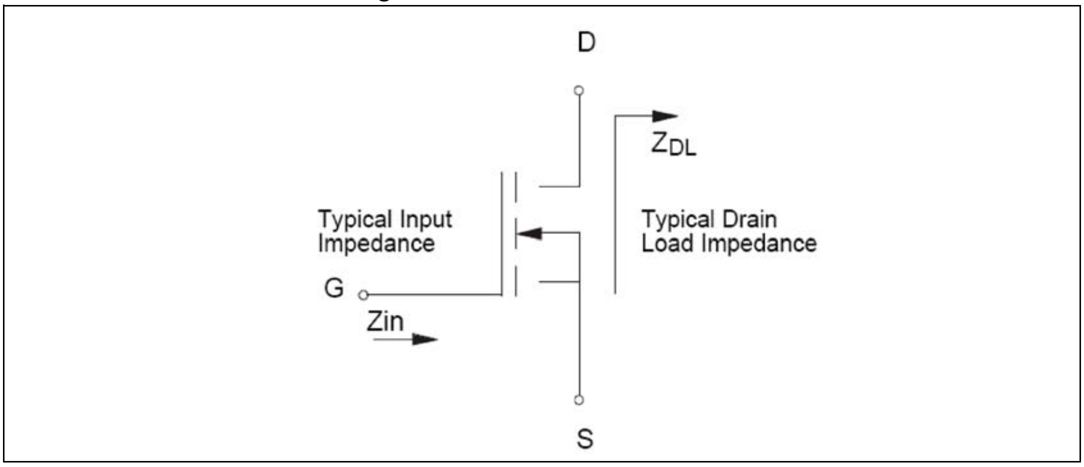


Table 6. Impedance data

Freq. (MHz)	Z_{IN} (Ω)	Z_{DL}(Ω)
175 MHz	2.0 - j2.0	3.5 + j5.2

Note: Measured gate to gate and drain to drain, respectively.

4 Typical performance

Figure 3. Capacitances vs drain supply voltage

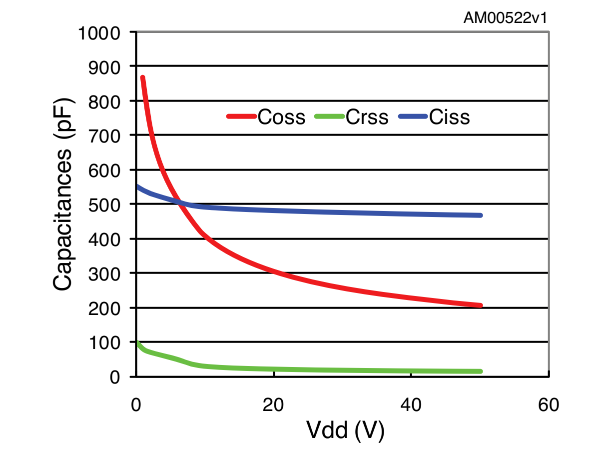


Figure 4. Output power vs drain supply voltage

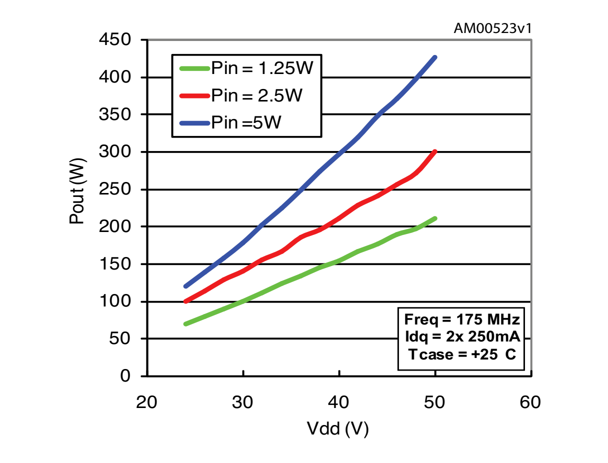


Figure 5. Output power vs gate voltage

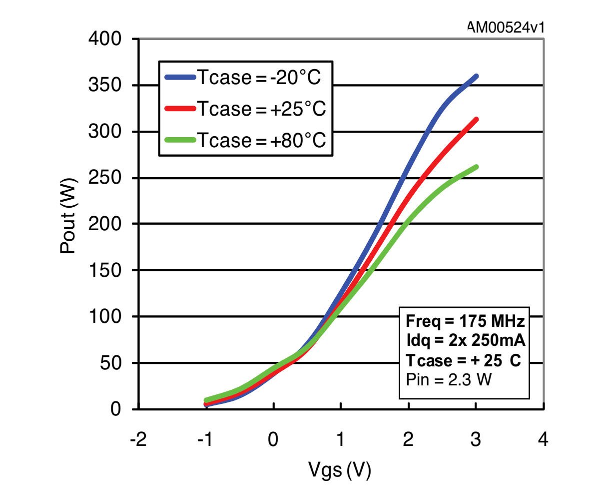


Figure 6. Output power vs input power

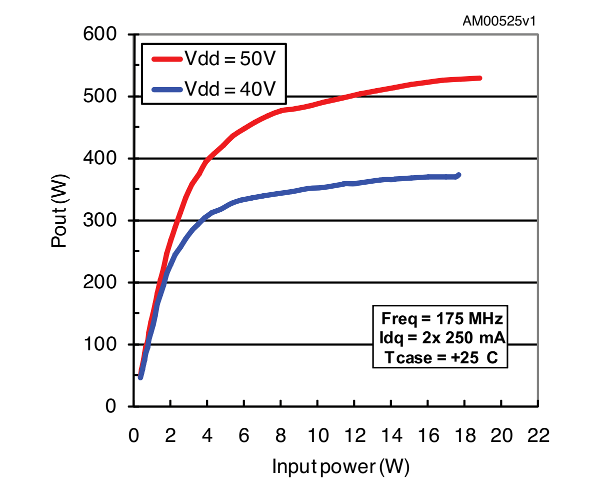


Figure 7. Output power vs input power and case temperature

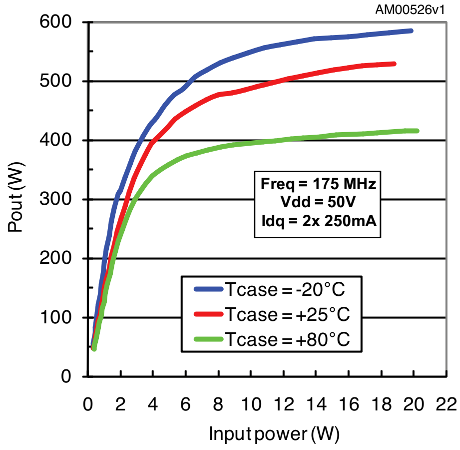
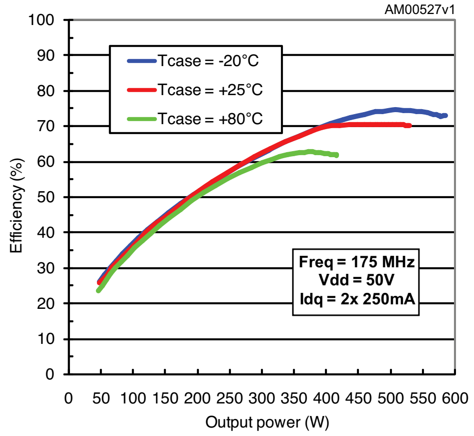


Figure 8. Efficiency vs output power and case temperature



5 Test circuit

Figure 9. 175 MHz test circuit schematic (production test circuit)

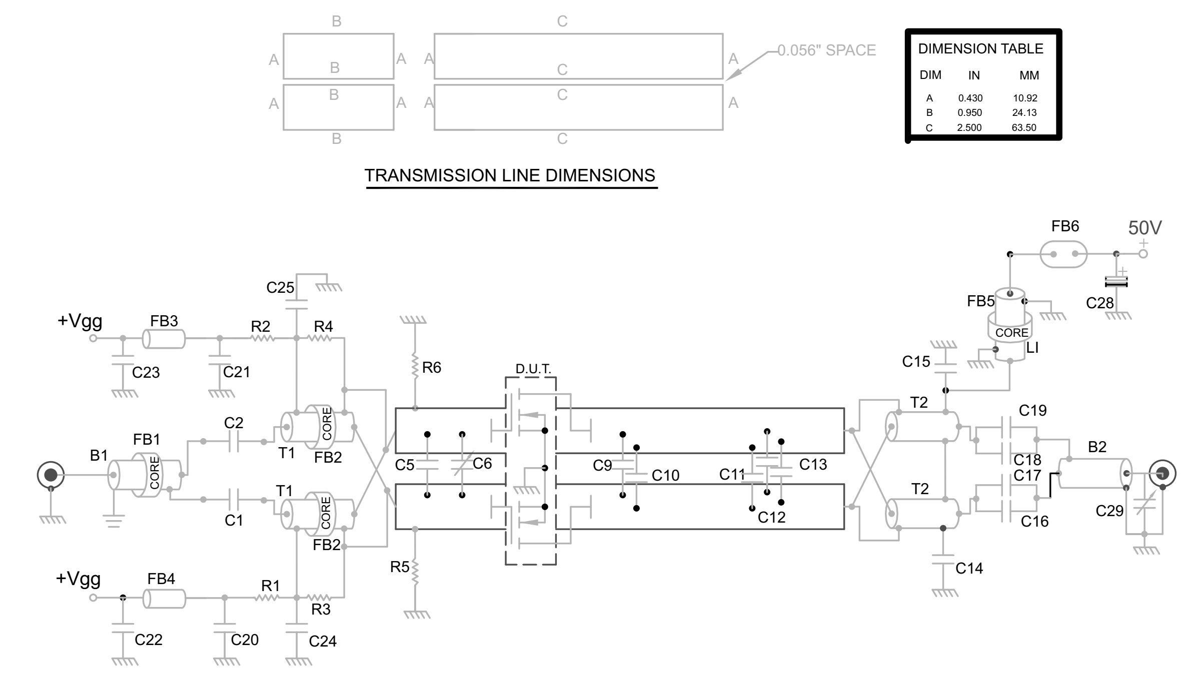


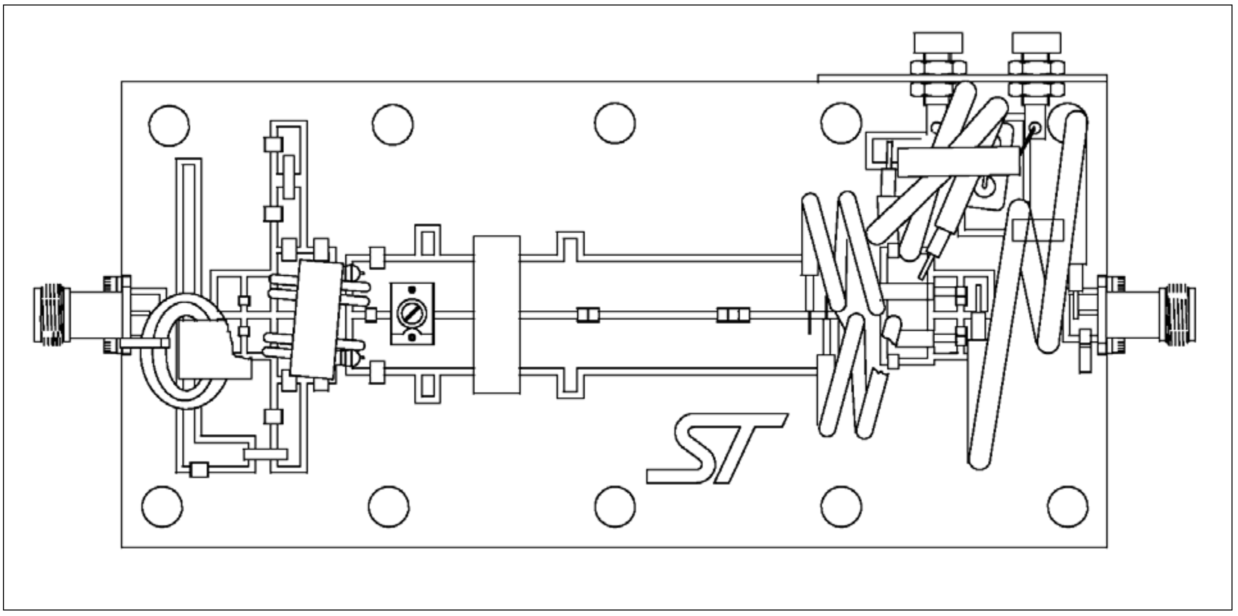
Table 7. 175 MHz test circuit part list

Component	Description
C1, C2, C14, C15, C24, C25	1200 pF ATC 700B chip capacitor
C5	75 pF ATC 100B chip capacitor
C6	ST406 variable capacitor
C9, C10	47 pF ATC 100B chip capacitor
C11, C12, C13	43 pF ATC 100B chip capacitor
C16, C18	470 pF ATC 100B chip capacitor
C17, C19, C20, C21	10,000 pF ATC 200B chip capacitor
C22, C23	0.1 µF 200 V chip capacitor
C28	10 µF 100 V electrolytic capacitor
C29	0.8 - 8 pF variable capacitor
R1, R2, R5, R6	430 Ω, 1/2 W chip resistor

Table 7. 175 MHz test circuit part list (continued)

Component	Description
R3, R4	270 Ω 1/2 W axial lead resistor
B1	RG-316 50 Ω 11.8" thru ferrite toroidal
B2	RG-142 50 Ω 11.8"
T1	4:1, RG-316 25 Ω, 5.9", 2 turns thru ferrite core
T2	1:4, 25 Ω semi-rigid cable, OD.141”, 5.9"
L1	λ/4 inductor, RG-142 50 Ω, 11.8", 3 turns thru ferrite toroid
FB1,FB5	Ferrite toroidal
FB2, FB6	Multi-aperture core
FB3, FB4	Surface mount ferrite bead
PCB	Rogers ultralam 2000, Er 2.55, 0.060”

Figure 10. Circuit layout



6 Package mechanical data

In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK® specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK is an ST trademark.

Figure 11. STAC244B mechanical data drawing

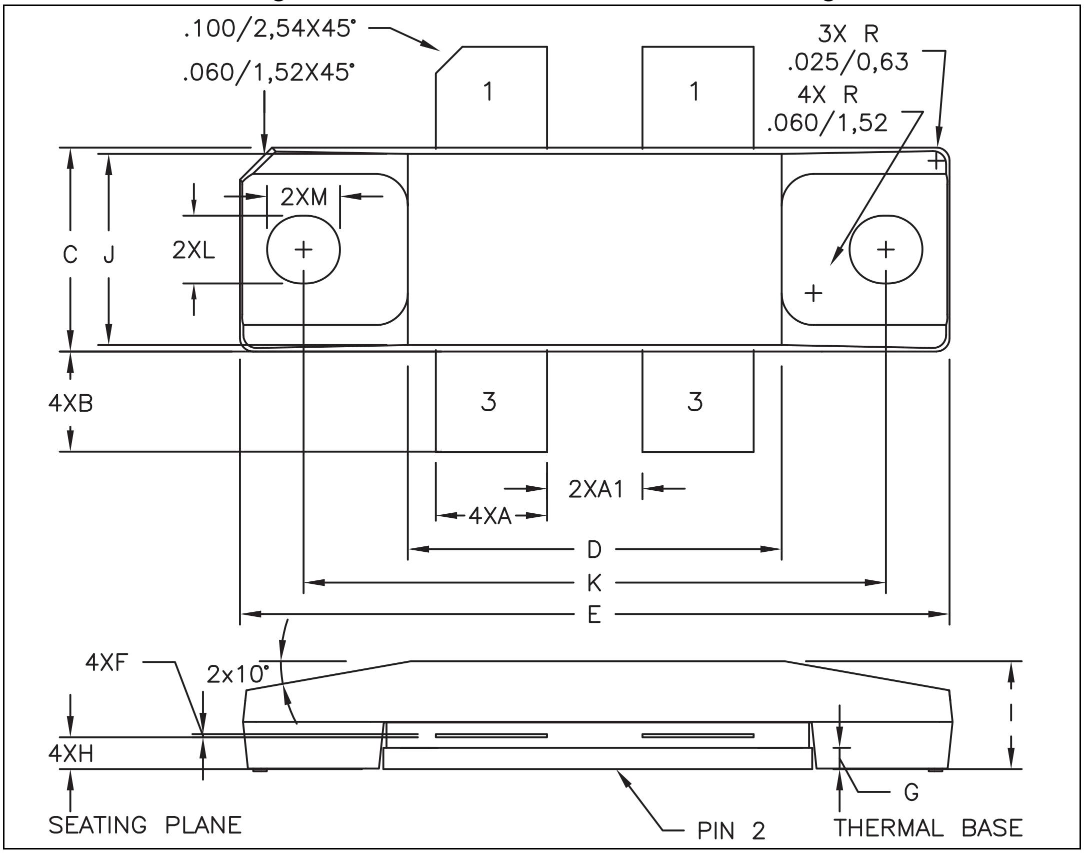


Table 8. STAC244B mechanical data

Dim.	mm		
	Min.	Typ.	Max.
A	5.08		5.59
A1	4.32		4.83
B	4.32		5.33
C	9.65		9.91
D	17.78		18.08
E	33.88		34.19
F	0.10		0.15
G		1.02	
H	1.45		1.70
I	4.83		5.33
J	9.27		9.52
K	27.69		28.19
L	3.12	3.23	3.33
M	3.35	3.45	3.56

7 Marking, packing and shipping specifications

Table 9. Packing and shipping specifications

Order code	Packaging	Pcs per tray	Dry pack humidity	Lot code
STAC2932BW	Tray	20	< 10 %	Not mixed

Figure 12. Marking layout

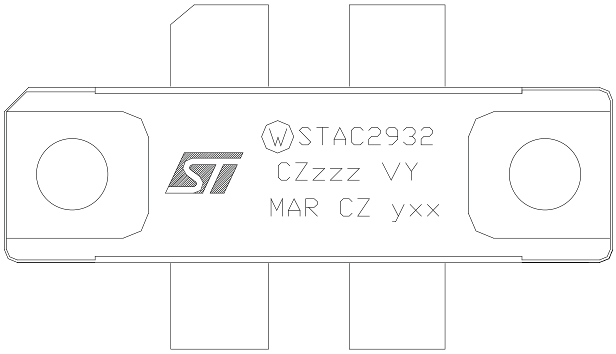


Table 10. Marking specifications

Symbol	Description
W	Wafer process code
CZ	Assembly plant
xxx	Last 3 digit of diffusion lot
VY	Diffusion plant
MAR	Country of origin
CZ	Test and finishing plant
y	Assembly year
yy	Assembly week

8 Revision history

Table 11. Document revision history

Date	Revision	Changes
20-Mar-2009	1	First release.
29-Jun-2010	2	Updated features and description on cover page.
12-Aug-2011	3	Update figures on coverpage and *Section 6: Package mechanical data*. Inserted *Section 7: Marking, packing and shipping specifications*. Minor text changes.
05-Sep-2011	4	Update L and M dimensions *Table 8 on page 11*.
12-Jan-2012	5	Minor text changes to improve readability.
27-Jan-2014	6	Modified pin labeling in *Figure 1: Pin connection*.

Please Read Carefully:

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения **«JONHON»**, а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов **«FORSTAR»**.

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А